⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

平2-279718

®Int. Cl. ⁸

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)11月15日

C 08 G 59/20 59/30 59/62

8416-4 J 8416-4 J

8416-4 J ×

審査請求 讀求項の数 2 (全8頁)

会発明の名称

エポキシ樹脂ペースの潜像形成組成物

平2-47393 夏 创特

22出 願 平2(1990)3月1日

優先権主張

621989年3月3日68米国(US) 62318536

79発 明 リチヤード・アレン・

アメリカ合衆国ニユーヨーク州ホワイトニイー・ポイン

ト、ポツクス320エー、アール・デイー 1番地 アメリカ合衆国コネチカツト州プレインヴイレ、ヘミング

明 者 ジエフリイー・ドナル

ウエイ・ストリート30番地

ド・ジエローム

インターナショナル・

アメリカ合衆園10504、ニユーヨーク州 アーモンク(番)

地なし)

の出願人

四代 理 人

個発

ピジネス・マシーン

ズ・コーポレーション 弁理士 山本 仁朗

外1名

最終頁に続く

1. 発明の名称 潜像形成组成物

2. 特許欝求の範囲

(1) エピクロロヒドリンとピスフエノールAとの 箱合物であり、約40000から約130000 の間の分子量を有する、重量比で約20%から4 0%の間のポリオール樹脂と、

約4000から約10000の間の分子量を有 する、重量比で約20%から約35%の間のエポ キシ化された八価機能のピスフェノールAフォル ムアルデヒド・ノボラツク樹脂と、

約600から約2500の間の分子量を持ち、 約60℃乃至約110℃の間の軟化点を有する、 重量比で約35%から約50%の間のテトラブロ モ・ピスフエノールAのエポキシ化されたグリシ ジル・エーテルと、

化学作用輻射線に露出した時、上記エポキシ化 された樹脂系の重合を発生させることが出来る。

重量比で約0.1部から約15部までの比率のカ チオン・フオトイニシエータと、

から成るエポヤシ樹脂系を含み、0.0508 ミリメートルの厚さの被膜が、330ナノメート ル乃至700ナノメートルの領域に対して0.1 以下の輻射線吸収率を持つことを特徴とする、カ チオン食合可能なエポキシ樹脂ペースの樹像形成 組成物。

(2) エピクロロヒドリンとピスフエノールAとの 縮合物であり、約40000から約130000 の間の分子量を有する、重量比で約10%から8 0%の間のポリオール樹脂と、

約4000から約10000の間の分子量を有 する、重量比で約20%から約90%の間のエポ キシ化された八価機能のピスフエノールAフォル ムアルデヒド・ノボラツク樹脂と、

化学作用輻射線に露出した時、上記エポキシ化 された樹脂系の食合を発生させることが出来る、 重量比で約0.1部から約15部までの比率のカ チオン・フオトイニシエータと、

特開平2-279718(2)

から成るエポキシ樹脂系を含み、0.0508 ミリメートルの厚さの被膜が、330ナノメート ル乃至700ナノメートルの領域に対して0.1 以下の幅射線吸収率を持つことを特徴とする、カ チオン重合可能なエポキシ樹脂ペースの潜像形成 組成物。

3. 発明の詳細な説明

A. 産業上の利用分野

本処明は光線で潜像を形成させる組成物、より 詳細に言えば、フォトイニシエータと、選択的に 与えられる光増感剤とを有するカチオン重合可能 なエポキシ樹脂系の材料に関し、この樹脂系は秀 れた複動性及び潜像形成性能を有している。

B. 従来の技術及びその課題

光線で潜像を形成させる組成物 (photoimagable composition)、即ち属光式潜像形成組成物を、製造工程に導入して製品を製造する方法には多数の例がある。或る特定の例において、露光式潜像形成組成物をプリント回路基板に被着することによってハンダ付け用のマスクとして、この組成物が

スクとして用いられる場合には、熔融はんだから 機隔されるべき基板上の部分を被う後覆の機能を 維持するように、はんだマスクは、はんだ付けに より、その性質が劣化しないように、はんだ付け 処理に対する充分な物理的及び化学的な耐性を持 つものでなければならないことは言うまでもない。 また、はんだ付け以外の用途に用いられる場合に は、その用途に応じた性質が要求される。

エボキシ樹脂を用いた多くの材料を含む電光式の潜像形成組成物は、従来から多数提案されている。 これらの材料は、例えば米国特許第4279985号、 同第4548890号、 同第4351708号、 同第4138255号、 同第4069055号、 同第4250号、 同第4654461号、 同第46544623号、 同第4684624912号、 同第4693981号、 同第4624912号、 同第4693981号、 同第4442

利用されている。この例において、組成物が被称された後、フォトリソクラフ技術を用いて、被覆を除去することにより、回路基板上の金属面を露出させて、露出されたパターンに任意の形式のはんだ付け処理を適用することによつて、回路基板にはんだ付け処理を施す。はんだ付け処理の間で、はんだは回路基板の露出された金属面に付着するけれども、残留した組成物が、はんだ付け用のマスクとして作用する場所には、はんだは付着しない。

はんだマスク用の被覆材料は、適宜の方法によって処理対象物に付着させることが出来るよがな、 構成にされていることが必要である。例えば、なましい被着方法としてのカーテン・は要材料にしたが必要を付ったのに、被要材料になる程度の適助性を必要とする。更に、はんだマスクは、材料の与えられた被覆の厚さを通して、スクオトニシエータを重合するように、光流になって、または他の傾射線を充分に透過する性質を持つものでなければならない。また、被複材料が、はんだマ

用されるフォトイニシェータを開示しており、それらの多くのものは、はんだマスクに使用される ものである。然しながら、本発明の組成に関する 組成については、較示、または開示がない。

C. 課題を解決するための手段

本発用に従つて、露光により潜像を形成し得るカチオン重合可能なエポキシ樹脂ペースの新規な被覆材料が与えられる。本発明の被覆材料は、約4000から約130000の間の分子量を有するエピクロロヒドリンとピスフェノールAとの総合物である重量比で約10%から約80%の間のポリオール樹脂と、約4000から約10000同の分子量を有する、重量比で約20%から約90%の間のエポキシ化された八価機能の

(octafunctional)ピスプエノールAフォルムアルデヒド・ノボラツク複磨と、若し、腱底性が必要ならば、約600から約2500の間の分子量を持ち、約90℃乃至約110℃の間の軟化点を有する、重量比で約35%から50%の間のテトラプロモ・ピスプエノールAのエポキシ化された

プリシジル・エーテルとから実質的に構成される、 エポーシ樹脂系を含む。上述の樹脂系に対して、 化学作用輻射線に露出された時、上記を開始を露出された時、上記を開始を開始すると、 でれた樹脂系のカチオン重合を開始を重量で100 来るフォトイニシェータの樹脂を重量で100 の被長によるのが、または強化である。 たいのでは、重量で約10年での場所が選択がある。 ために、重量で約10年での場所が選択がある。 ないで樹脂系は、組成物の0.0508ミリトレルの関さの被脱へ、330ナノメートルの領域に対し0.1以下の額射線吸収率を持つ。

D. 実施例

本発明は、フォトイニシエータと、選択的に与えられる光増感剤とを有する脳イオン的な食合、 即ちカチオン重合されるエポキシ樹脂系で構成された潜像形成組成物の被覆材料を与える。この組成物の樹脂系は、カーテン・コーティング技術を 速用することと、プリント回路基板上のはんだマ

ず、そしてまた、はんだ付け処理の間で、フイルムの性質が劣化しないように物理的にも、化学的にも充分な耐性を持つていなければならない。 を教を形成する場合において、所望ないのような特定を形成で多くの問題点を考慮しない。 教とののでは、ないないのでは、ないが、本発明に従って、幾つかのエポーシを引いない、ないの組合せ、即ち混合物は、カーデン・コーティンの組合せ、即ち混合物は、カーデン・コーティンの組合せ、即ち混合物は、カーデン・コーティンの組合を表現が可能であり、光線で潜像形成が可能ないなって、

一般に、このエポキシ樹脂系は、エピクロロヒドリンと、ピスフェノールAとの間の縮合物である高分子量のフェノキシ・ポリオール(phenoxy polyol)樹脂で実質的に構成されている。このタイプの適当な樹脂は、商標名「PKHC」の下でユニオン・カーパイド社から市販されている樹脂である。この樹脂は、1キログラム当り約0.03当量のエポキシド(epoxide)と、約37000

スクとして使用することとに特に渡している。然 しながら、触刺マスクなどのような他の目的に応 用することが出来るし、またローラ・コーテイン グのような他の被覆技術によつて被覆することが 出来る。この特定のはんだマスクの代表的な実施 例の材料は、通常のカーテン・コーティングの技 術によつて、約0.0127ミリメートル(0. 5ミル)乃至約0、1018ミリメートル(4. 0ミル)以上の浮さで基板上に被着し、乾燥され、 露光され、そして現像された。現像された領域は、 はんだが付着される基板の所望の下側の金属部分 を汲わし、そして強りのほんだマスク材料は硬化 されて、任意の技術によるはんだ付け処理の間、 はんだマスクとして基板上に残留する。従つて、 本発明の樹脂系は、カーテン・コーティング技術 の適用に対して充分な流動性を持たねばならず、 また、通常330ナノメートル乃至700ナノメー トルの寸法の領域を輻射線に露出した時に、著し く輻射線を吸収することなく、輻射線がフイルム を完全に通過して感光させるものでなければなら

のエポキシド当りの重量と、約98℃のTg(ガラス選移温度)とを持つている。この系の第2の機関は、中間的な分子量を有するエポキシ化された八価機能のピスプエノールAフォルムアルデヒド・ノボラックである。このタイプの適当な機関は、耐爆名「EplRez SU-8」の下でハイテク・ポリマーズ社(Righ Tek Polymers

Corporation)から市販されている樹脂である。この樹脂は、1キログラム当り的4.7当量のエポキシドと、約215のエポキシド当りの重量と、約82℃の熔酸点を持つている。これら2つの樹脂は、はんだマスク用のカーテン・コートに必要な流動性及びフォトリソグラフ向きの性質と、物理的な性質とを備えている。然しながら、多くの場合、鍵盤性が必要であるけれども、これら2つの樹脂は、多くの処理に要求されている鍵盤性を満足させる性質を持つていない。そのような場合に、第3の樹脂が、鍵盤性を向上させるために添加される。この樹脂系のそのような第3の樹脂は、テトラプロモ(tetrabromo)ピスフェノールAの紙

い分子量の高い軟化点のエポキシ化したグリシジ ル・エーテルである。このタイプの適当な機関は、 商様名「BpiRez 5183」の下でハイデ ク・ポリマーズ社で市販されている樹脂である。 この樹脂は1キログラム当り約1.5当量のエポ キシドと、約675のエポキシド当りの重量と、 約97℃の熔融点を持つている。穏々のスルフオ ニウム塩、ヨードニウム塩及びフエロセン塩など のフォトイニシエータが、この樹脂システムに添 加され、とれにより、輻射線に対して、適当な光 化学反応を起させる。この樹脂系列は光化学反応 で硬化されるので、フオトイニシエータは、輻射 線に露出した時に樹脂を光化学的に重合化させる 能力を持つものでなければならない。1つの好ま しいフォトイニシエータは、磁標名「UVB 1 014」の下でゼネラル・エレクトリツク社で販 売している錯体のトリアリルスルホニウム

(triaryisulfonium)・ヘキサフルオロアンチモン酸塩である。商標名「UVE 1014」の下でセネラル・エレクトリツク社で販売しているト

論として、分子量40000万至130000、 好ましくは60000万至90000の範囲のポ リオール樹脂を、約20%乃至40%、好ましく は25%乃至35%の範囲で使用出来ることが判 つている。上述の樹脂に組合せる樹脂として、約 4000万至10000、望ましくは5000万 至7000の分子量を有するエポキシ化されたノ ポラツク樹脂を約25%乃至35%、望ましくは 25%乃至30%の割合で使用することが出来る。 更に、約600万至25.00の分子量、望ましく は約1000乃至1700の分子量を有するエポ キシ化され臭化されたピスフェノールAを35% 乃至50%、好ましくは、約40%乃至45%の 割合で使用するのが好ましい。選択的な添加物と して、フォトイニシエータが混合され、必要に応 じて光増膨剤がこの樹脂組成物に添加される。重 量にして、100部の樹脂組成物に対して、通常、 約0. 1部から約15部までのフォトイニシエー タが必要とされ、重量にして100部の樹脂組成 物に対して、選択的に、約10 部までの光増級剤 リフエニルスルホニウム・ヘキサフルオロリン酸塩及びジフェニルヨードニウム・ヘキサフルオロアンチモン酸塩などが他のフォトイニシエータとして使用することが出来る。また、アントランセ、またはその誘導体、取はペリレン(perylene)またはその誘導体のような光増感剤を添加することが出来、そのような増感剤は先による像形成の応答速度、または光の波及感度を増加することが出来る。他の実施例では、上述した樹脂とは異なった取る範囲の分子量を持つエポキシ樹脂が取る割合で混合される。

大体 4 0 0 0 0 0 乃至 1 3 0 0 0 0 の範囲の分子量を有する約 1 0 % 乃至 8 0 % のポリオール機脂と、約 4 0 0 0 乃至 1 0 0 0 0 の間の分子量を有する約 2 0 % 乃至 9 0 % のエポキシ化されたノボラツク機脂とが望ましい組合せであることが判っている。これは、 難燃性を要件としない場合の一般的な基準である。 然しながら、 糠燃性は絶対に 公要な特性ではないにしても、 しばしば必要とする要件である。 難燃性が問題にされる場合、一般

が使用される。(潜像形成材料を取り扱う技術分野における一般慣行として、樹脂組成物の成分を百分率で100%まで組合せて表示し、この組成物に対する添加物については、重量比で樹脂組成物100部に対して重量で何部を付加するかで表示しているので、本明細書の説明は、この慣行に従つている。)

要求される性能を最適化するために特定の成分が選択される。例えば、PKHCは被覆される材料の流動性を制御し、BplRez5183は難燃性を与え、SU-8は磁光度及び解像力を与える。

各樹脂の特定の量を選択する際に、任意の1つの 樹脂の濃度を増加することは、その樹脂に関連し た特定の性質も強くなるけれども、このことは、 残りの樹脂の濃度を減少することになり、その結 果、残りの樹脂に関連した特定の性質の機能を減 少することには注意を向ける必要がある。任意の 1つの樹脂が、上述した広範囲な混合比率を持 わると、カーテン・コートが可能な難燃性を持つ 高い分解能で、光で潜像を形成することの出来るは、んだマスク材料の特定の目的を満足することの出来ない性質の材料となる。

PKHCの量が減少すると、その結果のレオロ ジーは、材料を与えた時の被覆面が小さくなり、 硬化後の材料は脆くなる。BplRez 518 3 を被らすと、その結果の樹脂組成物は難燃性の 特性が低下され、そして若し、上述の範囲の最少 限の値以下の量にすると、糠燃性の品質は、例え はUL 94 VOの難燃性の要件などのような 或る種の特定された製造上の要件を満たすことが 出来ない。然しながら、BplRez 5183 を少しでも含ませれば、雅燃性は幾分かは改善さ れる。SU-8の濃度を減少すると、感光性(pho tospeed〉と解像度が低下し、若し、上述の範囲の 最少限の量以下にすると、感光度は、この実施例 で要求される特定の要件を満たさない。従つて、 最終的な製品の性質を所望のように最適化するた めに、材料の形成をパランスさせることについて、 これらの要件のすべてが考慮されねばならない。

に説明するカーテン・コーテイング技術が使用された。回路基板が上述のカーテンを通過すると、基板がこの材料で被覆される。カーテン・コーティングの装置は、貯蔵用のパン、ポンプ、粘質されるが形成される。被覆用ヘッドとを含んでいる。被覆でれるが形成された。このカーテンは、カーテンを通過したときに基板上に被着された材料を除いて、パンの中に落下し、一定の割合で再類される。被覆の粘度は200万至2000Cpsであり、乾燥後は、0.0127万至0.1016ミリメートルの範囲の厚さで被着された乾燥膜である。

ロール・コーテイング、巻線ロツド・コーテイング等の他のタイプの被着方法も使用出来る。

エポキシ樹脂及びフォトイニシエータのこれらの特定の組成物は、カーテン・コーテイング法によって、むらがなく、欠陥のない非常に良好な被覆を得ることが出来、約0.0508ミリメートルの厚さの被覆が回路基板上に被着された。 露光

との項の最後に掲げた第1表の4つの実施例は、 はんだマスクとして非常に良好な材料である。

第1表の各実施例の組成物は、プロピレン・グリコール・モノメチール・エーテル・アセテート(PGMBA)に提合され、これらの組成物は約40%の割合でPGMBA中にある。この溶縦中に溶かされたこれらすべての組成物は、回路基板上に非常に良好に付着する。然しながら、これらの組成物に対して、グリコール・モノメチール・エーテル、2メトオキシメタノール、2メトオキシエチル・アセテート、2エトキシエチル・アセテート、Nメチルピロリドン

(N-methylpyrrolidone)、プロピレン・カーボネート、またはガンマプチロラクトンのような中間的な種性溶媒も使用することが出来る。

はんだマスクとしての良好な組成物は第4の実 施例である。

これらの実施例に対して、潜像形成用の組成物 を自由に落下させて形成した「カーテン」によっ て、回路益板上にこの材料を被着するために、次

処理段階において、光線は被覆膜を通して下面に ほぼ完全に透過し、フォトイニシェータ及び感光 剤を除いた被膜は、この特定の光線に対して透明 である、即ち0.0508ミリメートルの厚さの 被復膜に対して0.1以下の吸収率を持つている。

レー式の現像装置と、現像被を物理的に抵押する 装置とが使用された。はんだマスクの硬化は、 架 外線輻射へはんだマスクを観光した後、オープン 内で150での温度で焼成することによつて行われた。 業外線の線量は、 毎平方センチメートル り1万至4ジュールの間で変化された。 焼1 要の は30分万至90分の間で変化された。 焼1 要の は30分万至90分の間で変化された。 焼1 での は30分万至90分の間で変化された。 焼1 での は30分万至90分の間で変化された。 焼1 での は30万 の実施例の場合の被着され、 焼成された 後のTgの値を第1 変に示してある。

例えば、希塩酸のような洗浄剤で表面の酸化物を除去し、ペンソトリアゾールのような酸化防止剤を強布した後、回路基板は、種々のはんだ付け方法を使用してはんだ付けを施すことが出来る。 実施例によりはんだマスクに使用されたはんだ付け処理には、ウェープ式はんだ付けと、気相式はんだ付けとの2つの方法が使用された。

ウエープ式はんだ付けは、回路基板上に電気素子を装着することを含んでおり、はんだ付け用のフラックスをはんだ付けされる金属面に塗布した

よつて検査された。視覚的な検査で確認した時に、 はんだ襲撃が材料を物理的に劣化していなければ、 はんだマスクは、はんだ衝撃テストをパスする。

ある種の製品については、或る種の付加的な物質を添加することが望ましい。例えば、蛍光染料、または染色材料が検査用、または姿飾的な目的で添加される。これらの添加物は、重量で100部に対して約0.001部乃至1部の割合で、過常、混入される。実施例で使用されたこれらの物質は、緑色シュウ酸塩、エチル・パイオレット及びロダミンBであつた。ある種の被覆に使用される場合、例えばスリーエム社で販売されているフルオラド

FC 430 (Florad FC 430)のような裏面活性剤を添加することが望ましい。通常、裏面活性剤は、調量で100部の原材料に対して0.01部乃至1部の量で混合される。これらの添加物は、被複材料の他の性質を著しく損なうものであつてはならないのは言うまでもない。別掲の第11表は好ましい種々の添加物を示してある。

また、別掲の第四表はPKHC及びSUー8だ

後、この金属面を熔融はんだの連続する波に接触させてはんだ付けを行う方法である。 気相式はんだ付けは、スクリーン、または他の適当な技術を用いることによつて、基板上の部出した金属のにはんだフラックスと、固形はんだとを置くことによつて行われる。回路基板に電気的常子を組みしたで、その組立体は、はんだの熔散温度以上の温度に維持した蒸気の中に通される。

第4の実施例は、通常の工業的な製造工程で見られるはんだの代表的なストレス状態の下で、は んだマスクの性能をテストする通常の方法である 以下の「はんだ衝撃」テストを使用した通常の状態ではんだ付けの強さがテストされた。

被覆を施された基板は露光され、現像され、そして完全に硬化された。処理された固路基板は、260℃±13°(500°F±25°)の温度の熔散はんだに10万至20秒両、浸渍された。熔散はんだに浸渍された後、回路基板は塩温まで冷却され、そして検査された。マスク材料に通常発生されるひび割れ、発泡などの欠陥が、視覚に

けを用いた場合の3つの実施例を示している。

第四表において、第10及び11の実施例はカーテン・コーテイングに良好な性質を示し、 はんだマスクとして使用される。 第12の実施例は、全体として良好な特性を持つているが、100℃におけるLogG゚がやや低い。 この低い値によって、この実施例の材料は、適合性が低いので、 はんだマスクとしての応用には適していないが、 他の分野に応用することが可能である。

種々の他のタイプの樹脂成分は、流動性の点か、 またはフォトリソグラフ的な見地から不充分である ことが見出されている。

本発明は特に、カーテン・コーデイングを使用 したはんだマスク用の組成物として説明してきた。 然しながら、本発明の材料は他の目的に使用する ことが出来、穏々の他の技術を適用することによ つて応用することが出来る。他の異なつた使用法 と被殺技術を使用する場合、それらの個々の要件 を満足させるために、上述の実施例に或る種々の 修正が必要である。例えばカーテン・コーティン

L o g G' (aXe)

グではなくて、ロール・コーティングを使用する 最適な値から変更されることもあるる。

(以	F	氽	Ė)
---	---	---	---	---	---

合、異なつた将媒を使用することもあつて、レロジー特性がカーテン・コーテイングのための きな値から変更されることもあるる。								LogG'(a)		60 60	6. 1	6.4	公の形式権力 17。	
以下余白)									180				125	トロメージで発わるれ
									T g(t)	7.3	7.8	7.8	7.8	動作スペットを使用し
								椒	UVB 1014 部/重要	M	ĸ	ю	ນ	本ンを形式 iler DSC7 でもる。
								- ##	% %d - 08	30.0	27.3	25.5	25.0	#行フレートを C7 (Perkin-E 100でのログ
							·		Rp - Re 2 5 183	50.0	45.4	41.7	45.0	25. 4ミリメートかの平台アントトを称り着む減着数スペクトロメータの形式権キケイ100型を設定された。 4人キソ・エケマーDSCT(Perlin-Elmsr DSC)を使用した欲めのれた。 http://pubmedsc.
									PKHC	20.0	27. 3	33.3	30.0	(a) 25.4 7700 (b) ベルギン (c) これはメ
									医	-	81	ო	4	3 23
	वसङ्ख	1	0.05	0.05	0.05#	0.05#			LogG' @1000	6. 7	4.3			
	夏面话性剂 ^{bc}	0.03		0.03	ı	0.03	•		1 0 8 C	•	•			•
	1014		. າບ	ю	ю	ស		採	5 U - 8(4)	2.7	75			
= .	SU-84	25	2.5	20	26	23	(Ot の設施。) F C 430。	**	. 5 0	89			 	·
松	51834	4 3	4 5	4 5	4 5	4.5	編集による四分巻。 機能も整御100億パンセの避難。 レルキレド(Flucrad)FC 43 マレゼイトゲコーソ オチルズナギファト		•	6 N		の音が単		
	PKHCa	30	30	30	30	30	a to		沒施 图	## ## ·	12		(
	光准例	ເດ	8	7	œ	6	 #							·

B. 発明の効果

本発明は、与えられた被覆の厚さを通して、フォトイニシェータを重合するように、光線、または他の輻射線を充分に透過して秀れた潜像形成性能を持ち、しかも種々の被覆技術を適用することの出来る良好なレオロジーを有し、必要に応じて難燃性を向上することが可能な、潜像形成用のエポキシ樹脂ペースの被覆組成物を与える。

出 顧 人 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション 代 理 人 弁理士 山 本 仁 朗 (外1名)

第1頁の続き

22発 明 者 デヴィド・ジョン・ラ

アメリカ合衆国ニユーヨーク州アパラチン、リツトル・ヒ

ツセル ル・ロード97ピー番地

ンス・トノイン1003年4

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.